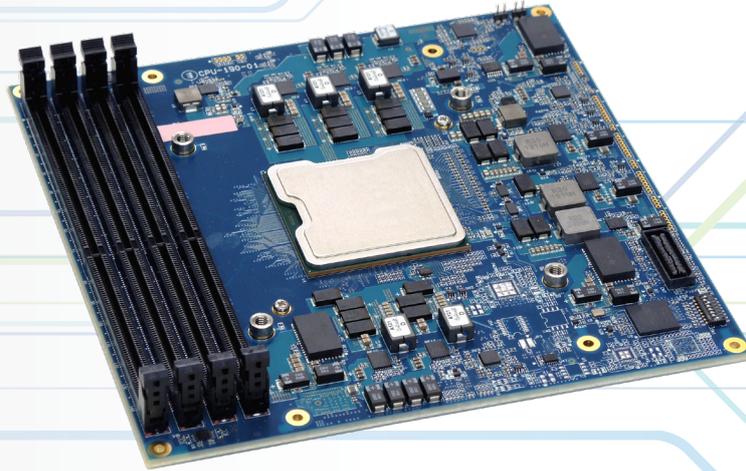


CPU-190-01



FEATURES

- Intel® Xeon® D-1700プロセッサシリーズ搭載
- DDR4 DIMM: 4ソケット (Up to 256GB)
ECC/nonECCサポート
- COM-HPC™ サーバモジュール
- PCI Express®: 35レーン
- NBASE-T (2.5G): 1ポート
- 10GBASE-KR: 5ポート
- Size D (160 x 160mm)
- Linux、Windows® 10 IoT Enterprise

CPU-190-01はIntel® Xeon® D-1700プロセッサシリーズを搭載したCOM-HPC™サーバモジュールです。より強力なCPUや高速な通信インターフェースがサポートされているCOM-HPC™規格とXeon® D-1700プロセッサシリーズを組み合わせた本製品は、高いパフォーマンスが求められるAIシステムや5G高速通信網におけるエッジコンピューティングに適しています。

本製品は、お客様のアプリケーションに合わせたコネクタやPHY等を搭載したキャリアボードと組み合わせることでご利用いただけます。コンピュータのコア部分がCPUモジュールとして設計・検証済みであるため、アプリケーションに合わせた機器開発のコスト・工期を抑えることが可能です。

ご用途に応じたBIOSのカスタマイズ、キャリアボードの開発、筐体やFW類を含めたシステム設計などのプロフェッショナルサービスもご提供しております。本基板をベースとしたカスタム製品のご相談も承ります。

CPU-190-01

Specifications

仕様

PROCESSOR	CPU	Intel® Xeon® D-1700 processor series
MEMORY	RAM	DDR4 UDIMM/RDIMM x4 (up to 256 GB, ECC/nonECC)
STORAGE	Embedded	1x SPI-Flash (BIOS) - 1x EEPROM
I/O INTERFACES	Ethernet PCI Express SATA USB Serial SPI eSPI SMBus I2C GPIO RTC Watchdog TPM Sensors	5x 10GBASE-KR, 1x NBASE-T (2.5G) 35 lanes 2 ports 2x USB3.2 Gen1, 4x USB2.0 2 ports Yes 1 port 1 port 1 port 12 Yes Yes TPM2.0 Temperature, Voltage
POWER	Input Consumption	VCC (12V±5%), VCC_5V_SBY(5V±5%), VCC_RTC (2.0 to 3.3V) TBD
ENVIRONMENT	Operating Temp. Storage Temp. Humidity	0 to 50°C -10 to 50°C 50 to 90% (No condensation)
CERTIFICATIONS	Environmental	RoHS (2011/65/EU, (EU)2015/863)
MECHANICAL	Dimensions	Size D (160 x 160mm)
SOFTWARE	OS	Linux, Windows 10® IoT Enterprise

※BIOSのカスタマイズも可能です。以下のお問い合わせメールまでお問い合わせください。
※VxWorks等その他のOSについては以下のお問い合わせメールまでお問い合わせください。



お問い合わせメール: sales@advanet.jp

 **Advanet**
Enabling the Future
A member of Eurotech Group

株式会社アドバネット

本 社 〒700-0951 岡山県岡山市北区田中 616-4
工 場 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉134-1
東京支社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目5-2 KDX鍛冶町ビル4F
お客様サポート <https://www.advanet.co.jp/contact-us/>
TEL 050-3196-5206 (受付時間:月~金 9:30~17:00、祝日を除く)

※記載されている会社名及び製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※仕様は予告なく変更されることがあります。